

Der Countdown läuft...

Elektronik wird ab 1. Juli in Europa bleifrei



Ab 1. Juli 2006 sind bleifreie elektrische und elektronische Produkte europaweit gesetzlich vorgeschrieben.

Schon seit 2003 (siehe Newsletter IV-2003) hat sich Greule auf diese Situation eingestellt.

Seither arbeiten wir auf die Umstellung hin. Während dieser Zeit haben wir zudem unsere Kunden über Prospekte, Newsletter, Schulungen, Vorträge, Technologietage - aber auch vielen persönlichen Gesprächen - informiert.

In unserem Hause haben wir EDV-technisch die Voraussetzungen für eine zweifelsfreie, absolut transparente Dokumentation jeder einzelnen Platinentypen in Bezug auf die RoHS-Konformität geschaffen. Organisatorisch sind alle Sonder-, Einzel-, und sonstigen Ausnahmemöglichkeiten geregelt und der Ablauf festgelegt.

In den letzten Tagen und Wochen mehren sich verständlicherweise die Anfragen, wie der aktuelle Stand in unserem Unternehmen zur „Bleifrei-Umstellung“ ist. Deshalb nachfolgend die Greule-spezifischen Eckdaten:



Neue Heizstäbe für höhere Temperaturen:
Die Chem.-Zinn-Anlage wird aufgerüstet.

1. Oberfläche HAL:

- bei Greule verwendetes Lot für HAL bleifrei: Balver SN100C
- die Horizontal-HAL-Anlage wird ca. Ende Juli 2006 auf Bleifrei umgerüstet.
- nach diesem Wechsel können in unserem Hause nur noch auf der Vertikal-Anlage Platinen in verbleiteter HAL-Oberfläche gefertigt werden. Aus anlagentechnischen Gründen ist dies jedoch auf kleinere und mittlere Seriengrößen beschränkt. Hierzu erfolgt noch ein separater Newsletter...

2. Oberfläche chem. Zinn:

- ebenfalls Anfang Juli wird unsere chem. Zinn-Durchlaufanlage durch mehrere zusätzliche Module und Spülen erweitert.
- durch diese Maßnahme können Zinnschichten von mind. 1 µm erreicht werden. Auch hierzu erfolgt noch ein separater Newsletter.



Auch die horizontale 45-Grad-Heißluftverzinnsanlage wird in Kürze auf Bleifrei umgestellt

AUS MEINER SICHT

Jörg Heinrich



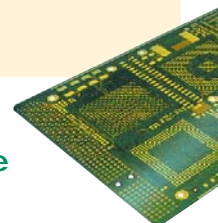
Geschäftsführer

Schon sehr früh haben wir uns eingehend Gedanken hinsichtlich der Umsetzung der EU-Richtlinie gemacht. Welche Oberflächen bieten wir unseren Kunden, welche Oberflächen fertigen wir direkt in unserem Haus, welche Voraussetzungen und Investitionen sind hierfür zu schaffen?

Die Kupferpassivierung, die HAL-Verzinnung (verbleit und bleifrei) und die chem. Verzinnung erfolgt weiterhin in unserem Hause. Hierfür wurden und werden bis zum August umfangreiche Umbau- bzw. Ergänzungstätigkeiten an beiden horizontalen Durchlaufanlagen vorgenommen. Lediglich die Gold-Oberfläche lassen wir über einen externen Dienstleister fertigen.

Wir sind bereit...

Auch organisatorisch, insbesondere EDV-technisch, wurden die Voraussetzungen für eine transparente und jederzeit lückenlose Dokumentation jeder Platinentypen geschaffen. Die Greule GmbH sieht der Bleifrei-Umstellung deshalb gelassen entgegen.



Generelle Informationen:

1. Temperaturen beim Oberflächenprozess:

- Die Leiterplatten sind von UL für Löttemperaturen von 288°C / 20 sec. bzw. 274 °C / 15 sec. zugelassen.
- Lt. unseren Erfahrungen und den Aussagen unserer Kunden können die Leiterplatten mit den üblichen Parametern / Löttemperaturen verarbeitet werden.

2. Angaben zur Lötbarkeit und zur Lagerfähigkeit:

- Lagerung in normaler Raumtemperatur bis 12 Monate (HAL und Nickel/Gold)
- nach dem oben genannten Umbau verlängert sich bei chem.Sn-Platinen die Lagerfähigkeit/Lötbarkeit durch die mind. 1µm-Zinnschichtstärke auf 12 Monate.

3. Kennzeichnung der bleifreien/Rohs konformen Produkte:

- Die Leiterplatte an sich wird nur nach zuvoriger Kundenforderung gekennzeichnet.

(Üblich im Layout z.B. durchgestrichenes Pb..)

- es erfolgt generell auf der kleinsten Verpackungseinheit (=Folienverpackung) und dem Karton auf der Etikette ein Hinweis „RoHS“ konform.

- auf der Auftragsbestätigung und dem jeweiligen Lieferschein wird ebenfalls RoHS-konform ausgedruckt.

- im beigegefügtm Greule-Prüfbericht wird die Oberfläche angegeben.

4. UL-Listung:

- die notwendigen UL-Freigaben der Materialien als auch der Prozess sind bei der UL in Bearbeitung.

- bei Multilayern ist eine Löttemperatur von 288 Grad Celsius zulässig.

- bei doppelseitigen Platinen in FR4-Material ist eine Löttemperatur von 274 Grad Celsius zulässig.

- bei Platinen in CEM1-Material ist eine Löttemperatur von 274 Grad Celsius zulässig.

PRODUKTION IM BILD

Die Zeit läuft:
Bleifreiheit in allen
Oberflächen
ab 1. Juli 2006



Chem. Zinn - Anlage



Heißluftverzinng an der 45°-Anlage



Organ. Kupferpassivierung

+++ greule intern +++ greule intern +++ greule intern

Das Messejahr zwischen SMT und electronica.



Herzlichen Dank für Ihren Besuch am Greule-Messestand. Am Ende der SMT 2006 steht für uns ein positives Resümee:

Der Rückblick auf die Messetage ist von vielen interessanten Fachgesprächen und einer steigenden Nachfrage nach unseren Leiterplatten bestimmt.

Der Greule-Fuchs konnte als sympathischer Repräsentant unserer Firma sein Revier auf dem Leiterplattenmarkt behaupten. Wir freuen uns heute schon, Sie auf der electronica 2006, vom 14. bis 17. November 2006 in München begrüßen zu dürfen.

Doppelsieg beim Mannschafts-Firmenschießen

Beim 15. Vereins- und Firmenschießen des Schützenvereins Calmbach bewiesen Greule-Mitarbeiter eine ruhige Hand.

Unter 20 Firmen-Teams belegte die Herrenmannschaft I den ersten Platz und die Herrenmannschaft II Platz 3.

Die Greule-Damen belegten ebenfalls Platz 1 von insgesamt 9 Teams. Pokale für die besten Einzelschützen gingen an Claudia Greule (Platz 2) und Günter Genady (Platz 1).



Siegreiche Männer (V.l.n.r.):
Günter Genady (bester Einzelschütze),
Stefan Reule, Paul Kort, Andreas Burghard,
Carlo Aguglia und Michael Kiencke.



Treffsichere Damen (V.l.n.r.):
Claudia Greule (bestes Einzelergebnis),
Gabi Dittus und Evi Rexer.

Weitere Informationen?

Wenn Sie mehr über Greule-Leiterplatten erfahren wollen, Antworten auf technische Fragen suchen oder Interesse an einer Produktionsbesichtigung haben, sind wir gerne für Sie da. Sprechen Sie mit Herrn Gerhard Deißler:

Infotelefon Technik
07082/793-164

